



THP-100 Series 熱硬化型穴埋めインキ

Thermal Curable Permanent Hole-Plugging Materials

特徴 Features

THP-100DX7 & DX9

- ◇ 高 Tg/低 CTE High Tg/Low CTE
- ◇ 高信頼性：-65°C ⇔ 150°C、1000Cycleクラックなし
No crack after -65 ⇔ 150deg.C × 1000 cycles
- ◇ 低硬化収縮 Extra-low shrinkage after curing

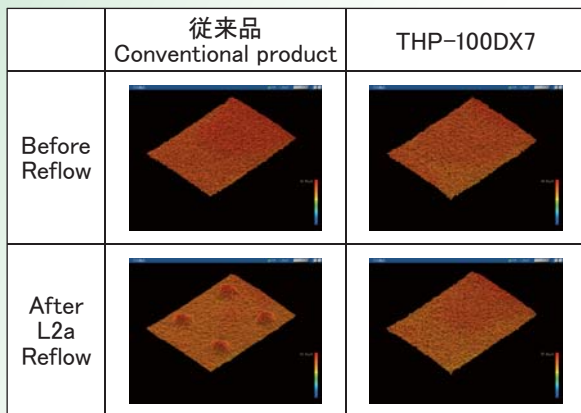
THP-100Z2シリーズ

- ◇ 保存安定性良好：有効期限180日(10°C以下保管)
Very long shelf life and quality stability for 180days
(Stored below 10deg.C)
- ◇ 短時間硬化：150°C/15分 Quicker curing time
- ◇ 高耐熱性：288°C/10sec/5cycleクラックなし
Higher thermal resistance. No crack at 288deg.C 10sec. × 5 cycles.
- ◇ 小径TH基板への印刷性良好
Excellent plugging ability to small diameter holes

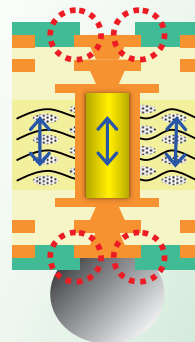
特性 Properties

	従来品 Conventional product	THP-100DX7	THP-100DX9	THP-100 Z2	Test Condition
粘度 (dPa·s)	450±50	450±50	500±75	350±50	コーンプレート型粘度計 Cone plate type viscometer
ガラス転移温度 (°C) Tg	150-160	165-175	175-185	150-160	TMA (Pulling mode) X-Y方向 X-Y direction
線膨張係数 (ppm) CTE (α_1/α_2)	30-35/100-110	20-25/55-65	15-20/50-60	40-45/110-120	
ヤング率 (Gpa) Young's modulus	4.5-5.0	5.0-6.0	8.0-9.0	4.0-4.5	引っ張り法 Pull-mode (室温 At room temperature)
破断点強度 (MPa) Tensile strength	50-55	60-70	60-70	45-55	
伸び率(%) Elongation	2.0-2.5	1.5-2.5	1.5-2.0	1.5-2.0	
吸水率(%) Water absorption	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	D-24/23, 塗膜厚み100 μ mt Resin thickness : 100 μ m
ピール強度 (N/m) Peel strength	>5.0	>5.0	>5.0	>6.0	引っ張り方向90° Pull-mode for vertical direction at 90°

THP-100DX7



- ◇ Core
T=0.4mmPTH=0.25mm
- ◇ Treatment
L2a (C-120/60/60)+
Reflow(270°C/5cycles)
※基板表面実温度



THP-100 Z2



高アスペクト比基板



トピックス Topics

- バックドリル仕様に対応したタイプを開発
- 低温硬化型穴埋めインキ
- 高多層基板に対応